

高纯金属检测，南京盐雾腐蚀试验室

产品名称	高纯金属检测，南京盐雾腐蚀试验室
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

高纯金属检测，南京盐雾腐蚀试验室

大家分享了芯片倒装焊凸点剪切力测试的相关知识，在本文中，【科准测控】小编将与大家分享倒装芯片剪切力测试的相关内容。芯片倒装焊凸点测试听上去好像跟倒装芯片剪切力测试差不多，但实际上两者之间有着很大差别。倒装芯片剪切力测试是测试底部填充前芯片与基板之间的剪切强度，或者是底部填充后对芯片所加力的大小，然后在该力产生的失效类型，判定器件是否能接收。而芯片倒装焊凸点测试是指要通过破坏性剪切测试评估倒装焊直径不大于80 μ m凸点的抗剪切能。下面我们就为大家简单讲解一下。

倒装芯片剪切力测试